

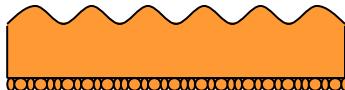
3EC-M3S-HTE

- ・圧延銅箔同様にアニールにより再結晶する高伸び・高屈曲電解銅箔。
High Elongation and flexibility after annealing, equally with RA copper foil.
- ・S面に表面処理を行い、3EC-HTEよりも低粗度を実現。
Lower profile compare with 3EC-HTE because of S-side surface treatment.
- ・2011年より日本だけでなく台湾・マレーシア拠点でも一部生産開始し、安定供給が可能です。
Stable supply is available because of 3-factory-production.

用途/Application

- ・フレキシブルプリント基板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生産拠点/Production Site

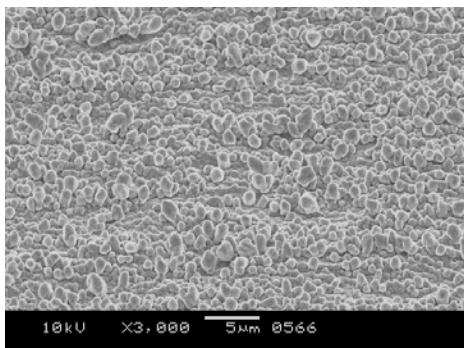
- ・日本/Japan
- ・マレーシア/Malaysia

代表的特性値/Representative date

	$\mu\text{ m}$	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz($\mu\text{ m}$)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
3EC-M3S-HTE	12	107	2.5	390	6	0.8
	18	153	2.5	390	10	0.9

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

